




本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20121106003
2012 年 12 月 6 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP-MCU BGA パッケージ 一部製品 組立部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**90** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、90 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	ASP-MCU BGA パッケージ 一部製品 組立部材変更 現行 : ボンディングワイア, モールド樹脂, Substrate 部材変更未対応 変更後: ボンディングワイア, モールド樹脂, Substrate 部材変更対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013年3月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 弊社 ASP-MCU(マイクロコントローラ) BGA パッケージ 一部製品について、機械/電气的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、ボンディングワイア, モールド樹脂, Substrate 部材を変更します。製品グループ毎の部材変更は下記の通りです。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	変更未対応	変更対応
モールド樹脂	変更未対応	変更対応
Substrate部材	変更未対応	変更対応

グループ	部材	現行	変更後
Group 1	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 mil, Au	0.80 mil, Cu
Group 2	モールド樹脂	G770	KMC3580 LT
Group 3	Substrate	Non-Green	Green
Group 4	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 mil, Au	0.80 mil, Cu
	Substrate	Non-Green	Green
Group 5	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 mil, Au	0.80 mil, Cu
	モールド樹脂	G770	KMC3580 LT
Group 6	Substrate	Non-Green	Green
	モールド樹脂	G770	KMC3580 LT
Group 7	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 mil, Au	0.80 mil, Cu
	Substrate	Non-Green	Green
	モールド樹脂	G770	KMC3580 LT

理由: 機械/電气的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名 - Group 1
Cu-wire 変更対象品

DEC63001ZFET

対象製品名 - Group 2
モールド樹脂変更対象品

F761560ZXF

対象製品名 - Group 3
Substrate 変更対象品

F761918AZDU	F761938ZDW
-------------	------------

対象製品名 - Group 4
Cu-wire/Substrate 変更対象品

F751916BGZDW	F761990B5ZDU	F761990C5ZDU	PF761990B5ZDU
F751916BZDW	F761990BZDU	F761990CZDU	PF761990BZDU

対象製品名 - Group 5
Cu-wire/モールド樹脂変更対象品

D710E001BGDH300	SP6727BZDH3D	SP6727BZDH3MA	TMS320C6727BZDH250	TMSC6727BZDH350TAN
D710E001BZDH275	SP6727BZDH3DA	SP6727BZDH3SABT	TMS320C6727BZDH275	TMSDC6727BZDHA250
D710E001BZDH300	SP6727BZDH3DABT	SP6727BZDH3SBT	TMS320C6727BZDH300	VCBUP6727BZDH300
D790E001BZDH275	SP6727BZDH3DABTE	SP6727BZDH3SBTE	TMS320C6727BZDH350	
D790E001BZDH300	SP6727BZDH3DBT	TMS320C6727BGDH275	TMS320C6727BZDHMUD	
D790E001BZDH300Z	SP6727BZDH3DBTE	TMS320C6727BGDH300	TMS320SP6727BZDH	
D790E002BZDH300	SP6727BZDH3M	TMS320C6727BGDH350	TMSC6727BZDH300TAN	

対象製品名 - Group 6
モールド樹脂/Substrate 変更対象品

TNETV1050DWZDW	TNETV1050NNZDW	TNETV1055INZDWASK	TNETV1056IPWZDW	TNETV1060F2BZDW
TNETV1050GWZDW	TNETV1050NPWZDW	TNETV1055IPBZDW	TNETV1056ZDW	TNETV1060F2SWZDW
TNETV1050INZDW	TNETV1050NPZDW	TNETV1055IPWZDW	TNETV1057EINZDW	TNETV1060F2SZDW
TNETV1050INZDWASK	TNETV1050ZDW	TNETV1055NNZDW	TNETV1057IDZDW	TNETV1060FIBZDW
TNETV1050IPBZDW	TNETV1055IDZDW	TNETV1055ZDW	TNETV1057ZDW	TNETV1060FNBZDW
TNETV1050IPWZDW	TNETV1055INWZDW	TNETV1055ZDW-ASKY	TNETV1058EINZDW	TNETV1060ZDW
TNETV1050IPZDW	TNETV1055INZDW	TNETV1056INZDW	TNETV1058ZDW	

対象製品名 - Group 7
Cu-wire/モールド樹脂/Substrate 変更対象品

TNETV1050GDW	TNETV1055GDW	TNETV1056GDW	TNETV1060F1BWGDW	TNETV1060V1BWGDW
TNETV1050GWGDW	TNETV1055GDW-ASKY	TNETV1056INGDW	TNETV1060F1SGDW	TNETV1060V1SGDW
TNETV1050INGDW	TNETV1055INGDW	TNETV1056IPWGDW	TNETV1060F1SWGDW	TNETV1060V1SWGDW
TNETV1050INWGDW	TNETV1055INWGDW	TNETV1056NPWGDW	TNETV1060FNBGDW	TNETV1060VNBGDW
TNETV1050IPBGDW	TNETV1055IPBGDW	TNETV1059ZDW	TNETV1060FNBWGDW	TNETV1060VNBWGDW
TNETV1050IPGDW	TNETV1055IPGDW	TNETV1060F1BWGDW	TNETV1060FNWGDW	TNETV1060VNSGDW
TNETV1050IPWGDW	TNETV1055IPWGDW	TNETV1060F2BGDW	TNETV1060FNWGDW	TNETV1060VNSWGDW
TNETV1050NNGDW	TNETV1055NNGDW	TNETV1060F2BWGDW	TNETV1060GDW	
TNETV1050NNWGDW	TNETV1055NNWGDW	TNETV1060F2SGDW	TNETV1060INGDW	
TNETV1050NPGDW	TNETV1055NPGDW	TNETV1060F2SWGDW	TNETV1060NNGDW	
TNETV1050NPWGDW	TNETV1055NPWGDW	TNETV1060F1BGDW	TNETV1060V1BGDW	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320SP6727BZDH-DM5/AU wire			
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDH/256	
Mount Compound:	4205402	Mold Compound:	4205401	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Au	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		78	
**T/C	-55C/125C, 200, 750 Cyc		77	
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320SP6727BZDH-DM5			
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDH/256	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4206745	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Cu	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000Hrs	77	77	77
**Auto Biased Temp Humidity	85C/85%RH, 168, 600, 1000Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**T/C	-55C/125C, 200, 750 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320SP6727BZDH-SMIC/AU wire			
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDH/256	
Mount Compound:	4205402	Mold Compound:	4205401	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Au	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**T/C	-55C/125C, 200, 750 Cyc	77	77	77
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320SP6727BZDH-SMIC			
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDH/256	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4206745	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Cu	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**T/C	-55C/125C, 200, 750 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F761990B5ZDU	-	-	
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDU/376	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4206745	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Cu	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-4/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	45	-	-
**High Temp. Storage Bake	150C, 168, 600, 1000Hrs	77	77	77
**Biased HAST	110C/85%RH, 264hrs	26	26	26
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**T/C	-55C/125C, 200, 500, 700, 1000 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-4/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F751916BGZDW	-	-	
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDW/376	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4206745	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Cu	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-4/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	45	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	110C/85%RH, 264, 528hrs	26	26	26
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**T/C	-55C/125C, 200, 500, 1000 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-4/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TNETV1050ZDW		-	-
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZDW/324	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4206745	
Bond Wire:	0.80Mil Dia., Cu	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-4/260C		-	-
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	45	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年7月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F761560ZXF- Au wire		-	-
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	BGA/ZXF/520	
Mount Compound:	4205412	Mold Compound:	4208515	
Bond Wire:	0.96Mil Dia., Au	Solder Ball composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-4/250C		-	-
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
Electrical Characterization	-	78		
**Autoclave	121C, 96hrs	78		
**T/C	-55C/125C, 200, 500, 1000 Cyc	77		
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec		
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-4/260C.				